

JEITA環境調和型先端実装技術 成果報告会2011 (旧 鉛フリー化活動成果報告会)

- 主 催：実装技術標準化専門委員会
- 担当部署：知的基盤部
- 参加者数：約100名

概 要

実装技術標準化専門委員会では、1997年から実装技術の鉛フリー化活動に取り組んで参りました。今年からは昨年までの「JEITA鉛フリー化活動成果報告会」から「JEITA環境調和型先端実装技術成果報告会」に名称を改め、この一年間の鉛フリー化活動成果及び環境に優しい先端的な実装技術の検討結果として、国

際標準化対応などの委員会成果報告のほか、「フロー槽材料の長期信頼性に係る各種特性の評価試験方法に関する標準化」と「第2世代リフロー用鉛フリーソルダーペーストの標準化」に関する取り組みの成果報告を行ないました。

プログラム

- 「来賓挨拶」
小竹幸浩 氏 (経済産業省 商務情報政策局情報通信機器課 課長補佐)
- 「電子部品のMSLによる分類と包装に関する国際規格化の取り組み」
反保昌博 氏 ((株)村田製作所)
- 「鉛フリーはんだの熱疲労寿命予測式について」
(1) 熱疲労寿命予測式のJEITA規格化について 山本 剛 氏 (富士通(株))
(2) 鉛フリーはんだの熱疲労寿命予測式について 苅谷義治 准教授 (芝浦工業大学)
- 「高温鉛入りはんだの鉛フリー化への取り組み」
芹沢弘二 氏 ((株)日立製作所)
- 「NEDOプロジェクトの取り組みについて」
竹本 正 教授 (大阪大学) / 芹沢弘二 氏 ((株)日立製作所)
- 「窒化処理膜などの表面拡散タイプ処理膜の損傷メカニズムと評価試験方法」
荘司郁夫 教授 (群馬大学)
- 「セラミックコート膜などのコーティングタイプ膜の損傷メカニズムと評価試験方法」
西川 宏 准教授 (大阪大学) / 芹沢弘二 氏 ((株)日立製作所)
- 「ステンレス鋼表面処理膜の鉛フリーはんだによる損傷評価・検証事例」
佐々木喜七 氏 ((財)日本電子部品信頼性センター)
- 「『第2世代リフロー用鉛フリーソルダーペースト標準化』プロジェクトの取り組み」
富塚健一 氏 (ソニーイーエムシーエス(株))
- 「落下衝撃試験などの機械的強度評価結果」
山田 聡 氏 (ルネサス エレクトロニクス(株))
- 「熱衝撃試験による熱疲労特性評価結果」
富塚健一 氏 (ソニーイーエムシーエス(株))
- 「プロファイル加熱法によるソルダーペーストの加熱条件評価結果」
平本 清 氏 (山陽精工(株))
- 「ソルダーペーストのマーケット動向」
大西 司 氏 (千住金属工業(株))
- 「SnBi系はんだの特徴」
苅谷義治 准教授 (芝浦工業大学)

